

Avis de Modification Produit / Process <i>Product / Process Change</i> <i>Notification</i>		Référence / Reference PCN 115485	
		Nb de pages / Nb of pages 2	Date de Diffusion / Issue Date 15/12/2014
Familles Produit / Product Families	169 - SMASH	Références Concernées / Concerned Part Numbers	HDC F 396 U01-000
Origine / Origin	Changement circuit flexible	Diffusion / Distribution	SAGEM

Sujet / Subject

Modification de la nature du circuit flexible du bloc électrique (épaisseur cuivre et fournisseur) – Optimisation du process d'assemblage notamment du cambrage du circuit flexible.

Le circuit flexible actuel n'offre pas les tolérances d'alignement attendues pour un bon report sur carte imprimée. Il ne présente pas la rigidité nécessaire pour maintenir une forme optimale. Le process de cambrage n'est pas suffisamment adapté/industrialisé.

Modification of the flexible circuit design (copper thickness & supplier) – Optimization of the assembly process, in particular the forming step.

P/N 169-164767-00 / HDCF396U01-000

The current flexi design does not offer the required tolerances of alignment for a good soldering on PC Board. It provides a poor memory of shape. The forming process needs to be improved and industrialized.

Modification / Nature of Change

- Suite à de premiers essais pour une bonne tenue de forme, augmentation de l'épaisseur de cuivre de 70µm à 150µm, en demi dur. Pour de bons alignements de conducteurs dans les tolérances : Rassembler toutes les terminaisons des conducteurs au niveau de la bande kapton organisatrice en une seule bande de cuivre, d'où un meilleur maintien pendant les retraits de coverlay. Pour un meilleur process d'assemblage : Modification des outils de cambrage.
- *Following first evaluations for a better memory of shape : Increasing of copper thickness from 70µm thru 150 µm, half hard. For better alignments of conductors, within the tolerances: Unify all the terminations in the kapton alignment strip area into one copper band, to avoid shrinkage effects on top coverlay. Improve the assembly process, starting by the forming tools.*

Références concernées et date / Affected part number and implementation date

Famille / Family	Références / Part Numbers	Date / Date
169 - SMASH	HDC F 396 U01-000	30/01/2012

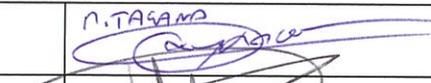
Personne à contacter pour plus d'information / Person to contact for more information

Nom / Name

E-mail

Liliane MARQUET : liliane.marquet@amphenol-socapex.fr

APPROBATIONS / Approvals

Engineering		Marketing	
Quality		Industrial	